

可拆卸端子 IC200CBL555 高负载启动

产品名称	可拆卸端子 IC200CBL555 高负载启动
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	207.00/件
规格参数	品牌:GE 型号:IC200CBL555 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

可拆卸端子 IC200CBL555 高负载启动

IC200NDD010	IC200CHS014	IC693CBL327
IC200UDD212	IC200UDD020	IC693MDL260
IC200PNS002	IC200NDD101	IC693CBL311
IC200CHS102	IC200CHS011	IC693CBL303
IC200CHS101	IC200CHS122	IC693CBL313
IC200UDD220	IC200MDL743	IC693NIU004
IC200UDR120	IC200MDL750	IC693CBK004
IC200CPU005	IC200CBL655	IC693MCD001
IC200UDD240	IC200CHS001	IC693MDL241
IC200CHS112	IC200CBL602	IC693PBS201
IC200CHS022	IC200CHS015	IC693CBL301
IC200PKG104	IC200CBL635	IC693CBK002
IC200NDR010	IC200CBL615	IC693CBK001
IC200UDD104	IC200UAL006	IC693MDL330
IC200NAL110	IC200MDL742	IC693PBM200
IC200PNS001	IC200UDD040	IC695RMX128
IC200NAL211	IC200MDL740	IC695CPU320
IC200NDR001	IC200CHS002	IC695CMX128
IC200MDL930	IC200CBL555	IC695ACC415
IC200CHS025	IC200CBL605	IC695ACC414
IC200CHS005	IC200UDD110	IC695ACC413
IC200CHS006	IC200MDL730	IC695CPK400
IC200CHS003	IC200CBL600	IC695EDS001
IC200CHS111	IC200CBL510	IC695ACC412
IC200MDL940	IC200CBL545	IC695CPE302

IC200CPU002	IC200CBL550	IC695CDEM006
IC200UDD112	IC200UAR028	IC695CPL410
IC200UDD120	IC200CBL525	IC695PNS101
IC200DEM103	IC200MDL741	IC695ALG626
IC200UDD064	IC200UAL005	IC695ALG608

可拆卸端子 IC200CBL555 高负载启动

工业软件领域迎来一个标志性的变革事件。

日前，Synopsys（新思科技）和Ansys宣布，双方已达成终协议。Synopsys将以350亿美元收购Ansys。交易完成后，原Ansys股东将总共持有16.5%的Synopsys股份。

有数据统计，Synopsys是全球EDA（芯片电子设计自动化）领域的三巨头之一，其在全球EDA市场的占比高达32.14%，第二、三名Cadence的23.4%和Siemens EDA的14%。而Ansys是CAE（计算机辅助工程）领域的头部企业，同样属于研发设计类核心工业软件。

据Synopsys所说，在收购完成后，Synopsys的芯片电子设计自动化（EDA）将与Ansys广泛的仿真分析产品组合强强联手，打造一个从芯片到系统设计解决方案领域的全球。可以预见的是，两家头部公司的合并将对全球整个仿真行业的竞争格局带来变化。

为何瞄准仿真软件领域？

工业仿真软件是一种利用计算机技术对工业生产过程进行模拟和分析的工具。工程师通过在电脑上模拟真实环境中的物理现象，从而在产品阶段就能预测和优化产品性能。对于缩短产品上市时间，降低研发成本等方面具有显著优势。

随着先进制造的需求不断增长，企业对降本增效要求不断提高，特别是汽车行业，智能驾驶技术和新能源汽车的推动下，仿真软件市场需求激增，拥有巨大潜力和增长空间。有研究数据表明，仿真软件市场规模预计将从2023年的108.2亿美元增长到2028年的191.2亿美元，预测期内（2023-2028年）复合年增长率为12.06%。

据悉，Ansys在仿真软件领域的市占率高达42%，其仿真软件产品广泛用于航天、半导体、汽车等多个工业领域。Synopsys与Ansys的合并，无疑进一步巩固了Synopsys在仿真软件领域的地位，获得竞争优势，同时扩大其在仿真软件市场的份额和布局。

Synopsys方面表示，与Ansys合并，有望战略性拓展整体潜在市场规模，Synopsys的整体潜在市场规模（TAM）预计将增长1.5倍，达到约280亿美元。

工业软件市场趋向集中化

工业软件三巨头的市场竞争格局初显于上世纪90年代，彼时，芯片技术快速发展，语言描述开始应用，EDA逐步成为主流。为了推进技术创新与应用，提高市占率和市场竞争力，三大巨头开启了频繁的收并购行为。有数据统计显示，在近三十年历史中，这些巨头参与了超过200次的并购，平均每家企业的并购次数高达70次。

工业软件领域内巨头合并或大鱼吃小虾的收购事件司空见惯，软件巨头的成长史往往都是通过一系列收并购动作来逐渐扩大自身的商业版图，对于Synopsys来说亦是如此，此次收购是其扩大市场份额，提升企业竞争力的一个标志性动作。

就在刚刚过去的2023年，Synopsys也完成了不少重要的收购。2023年的12月份，Synopsys低调收购了英国的RISC-V处理器模型、RISC-V验证解决方案和软件仿真虚拟原型提供商imperas。进一步巩固了Synopsys在RISC-V领域的地位；去年8月Synopsys宣布收购的PikeTec，计划将PikeTec的测试自动化工具和服务加入自身产品线，为汽车OEM提供更加全面的虚拟化和测试方案；去年5月，Synopsys收购专门为制造芯片、测试芯片提供相关的模拟EDA软件的公司Silicon Frontline，等等。

另外一大工业软件巨头Cadence同样收并购动作频频。近日，Cadence同样完成一件收并购大事，即对Invecas, Inc.的收购，Cadence将充分整合Invecas的技术实力，利用其知识为客户提供跨芯片设计、产品工程、封装技术和[嵌入式软件](#)的高度定制解决方案。2023年，Cadence还完成了三项重要收并购，分别是ARC、Intrinsix和Pulsic，以及对Rambus PHY IP的收购。

而Siemens EDA在过去一年中并未向前面两家一样频繁出手，仅完成了对Insight EDA公司的收购，该公司为许多的集成电路（IC）设计团队提供突破性的电路可靠性解决方案，收购Insight EDA，进一步完善了Siemens EDA在电路可靠性验证领域的技术路线图。

有人调侃，EDA企业不是在并购，就是在寻找收并购目标的路上。的确，收并购是软件企业迅速扩大市场份额和战略布局的重要手段，工业软件巨头通过收购和并购来获取新的技术和创新能力，以满足市场需求，并推动工业软件行业向更高水平发展。也正是因为这些收并购事件的完成，才有了工业软件市场的蓬勃发展和不断进步。

在本文收尾之际

，ABB宣布收购软件服务提供商

Meshmind，以扩大其在人工智能、工业[物联网](#)和[机器视觉](#)

领域的研发能力。收并购乃头部企业常态，无论是主动收购还是被收购，都将成为搅动行业技术鱼池的一潭活水。

可拆卸端子 IC200CBL555 高负载启动